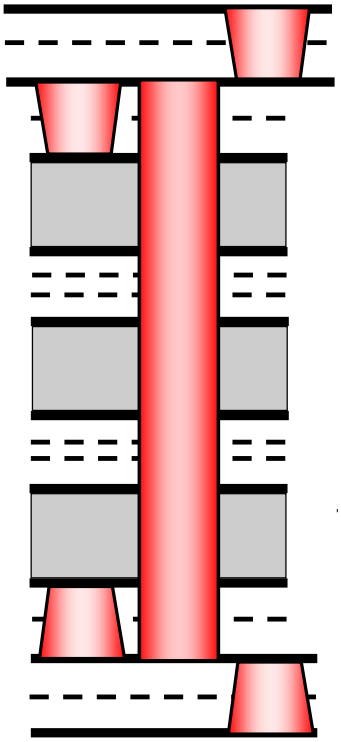
LAGENAUFBAU HDI (Standard)

HDI10_2+6(8b)+2_1,25_35 — **10 - Lagen** — Kerne: 0,15 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:	**2 + 6(8B) + 2**
KUNDE:	

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	LAGENBEZEICHNUNG WE	AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	60	
2	VSK1		Folie	12 µm		35	
					1 x 1080	60	
3	2			35 µm		33	
			0,150 mm			150	
4	3			35 µm		33	
					2 x 1080	124	
5	4			35 µm		33	
			0,150 mm			150	
6	5			35 µm		33	
					2 x 1080	124	
7	6			35 µm		33	
			0,150 mm			150	
8	7			35 µm		33	
					1 x 1080	60	
9	RSK1		Folie	12 µm		35	
					1 x 1080	60	
10	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	
			1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm				
			Gesamtdicke Material:			1230	
			Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)				

MATERIALDICKE:	**1,25**	+/-	0,11	mm		Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,34	+/-	0,14	mm			
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,40	+/-	0,16	mm			
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:		

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
27.03.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R.Schönholz	00	16+